

# PRESSEINFORMATION

-----  
PRESSINFORMATION19. März 2020 || Seite 1 | 2  
-----

## Panel Level Packaging auf dem Weg in die Zukunft: PLC 2.0

**Mehr als 50 internationale Gäste trafen sich Mitte Februar aus einem besonderen Anlass zum ersten Kick-off-Meeting am Fraunhofer IZM: Nachdem das internationale Panel Level Consortium 1.0 seine ehrgeizigen Projektziele für das Jahr 2019 mit signifikanten technischen Fortschritten im Bereich des großflächigen Fan-Out Panel Level Packaging erfolgreich umgesetzt hat, wurde nun ein neues Konsortium gebildet, das diesen Weg fortsetzen wird. Der besondere Fokus dieses „PLC 2.0“ Konsortiums liegt auf einer noch höheren Verdrahtungsdichte unter Verwendung feinerer Leitungsgeometrien im Bereich 2µm, einschließlich der Untersuchung von Kupfer-Migrationseffekten sowie der Verschiebung der im Substrat integrierten Komponenten und ihrer Verwölbungen bei großflächigen Panels.**

Das Projekt PLC 2.0 ist offiziell am 1. Februar 2020 gestartet und soll seine Ziele über zwei Jahre hinweg verfolgen. Das Konsortium besteht derzeit aus 17 internationalen Unternehmen aus aller Welt. Unternehmen jeder Art und Größe können sich beteiligen, wobei die Größe der beteiligten Firmen zwischen 300 und mehr als 122.000 Angestellten variiert. Unter ihnen befinden sich junge Akteure genauso wie erfahrene Firmen mit einer Geschichte, die bis in das Jahr 1832 zurückreicht, und in einem Fall ist der Unternehmenssitz sogar in 1.000 Metern Höhe über dem Meeresspiegel angesiedelt.

Derzeit sind folgende Firmen Teil des Konsortiums: Ajinomoto Fine-Techno Co., Amkor Technology, ASM Pacific Technology Ltd., AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG, Atotech, BASF, Corning Research & Development Corporation, Dupont, Evatec AG, FUJIFILM Electronic Materials U.S.A., Hitachi Chemical Company, Ltd., Intel Corporation, Meltex Inc., Nagase ChemteX Corporation, RENA Technologies GmbH, Schmolz Maschinen und Semsysco GmbH. Unternehmen, die an einem Beitritt zum PLC 2.0 interessiert sind, haben hierzu noch bis zum Sommer 2020 die Gelegenheit.

Die Forschung und Entwicklung des Konsortiums PLC 2.0 wird die Arbeit des PLC 1.0 fortsetzen, sich jedoch dabei auf eine Reihe spezifischer Ziele konzentrieren. Im Gegensatz zu der für PLC 1.0 gewählten Struktur wird es aufgrund der erfolgreichen Implementierung des Workflows nur eine Kategorie der Mitgliedschaft geben. Darüber hinaus hat das Fraunhofer IZM seine Panel Level Packaging-Linie um mehrere neue Anlagen erweitert, wie z. B. ein neues Gerät zur High-Speed-Montage, neue Lithographiewerkzeuge, die die 1 µm-Schallmauer bei der Auflösung durchbrechen, und neue Beschichtungs- und Ätzwerkzeuge.

---

### Presse

**Susann Thoma** | Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM | Telefon +49 30 46403-745 | Gustav-Meyer-Allee 25 | 13355 Berlin | [www.izm.fraunhofer.de](http://www.izm.fraunhofer.de) | [susann.thoma@izm.fraunhofer.de](mailto:susann.thoma@izm.fraunhofer.de) |

**FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR ZUVERLÄSSIGKEIT UND MIKROINTEGRATION IZM**

Die Investitionsgelder für diese Anlagen wurden durch die Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland) ermöglicht.

-----  
**PRESSINFORMATION**

19. März 2020 || Seite 2 | 2  
-----

Weitere Informationen werden im Laufe des Jahres 2020 regelmäßig veröffentlicht. Erste Ankündigung: Das 4. öffentliche PLP-Symposium ist für den 30. Juni geplant.



*Das PLC 2.0 Konsortium, bestehend aus 17 internationalen Unternehmen, greift nach der nächsten Stufe im Fan-Out Panel Level Packaging. © Fraunhofer IZM*

**Mehr Informationen:**

[https://www.izm.fraunhofer.de/de/institut/netzwerk\\_weltweit/panel-level-consortium-2-0.html](https://www.izm.fraunhofer.de/de/institut/netzwerk_weltweit/panel-level-consortium-2-0.html)

---

Die **Fraunhofer-Gesellschaft** ist die führende Organisation für angewandte Forschung in Europa. Unter ihrem Dach arbeiten 72 Institute an Standorten in ganz Deutschland. Mehr als 26 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten das jährliche Forschungsvolumen von 2,6 Milliarden Euro. Davon fallen 2,2 Milliarden Euro auf den Leistungsbereich Vertragsforschung. Rund 70 Prozent dieses Leistungsbereichs erwirtschaftet die Fraunhofer-Gesellschaft aus Aufträgen der Industrie und öffentlich finanzierten Forschungsprojekten. Internationale Niederlassungen sorgen für Kontakt zu den wichtigsten gegenwärtigen und zukünftigen Wissenschafts- und Wirtschaftsräumen.

Das **Fraunhofer IZM**: Unsichtbar – aber unverzichtbar: nichts funktioniert mehr ohne hoch integrierte Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik. Grundlage für deren Integration in Produkte ist die Verfügbarkeit von zuverlässigen und kostengünstigen Aufbau- und Verbindungstechniken. Das Fraunhofer IZM, weltweit führend bei der Entwicklung und Zuverlässigkeitsbewertung von Electronic Packaging Technologien, stellt seinen Kunden angepasste Systemintegrationstechnologien auf Wafer-, Chip- und Boardebene zur Verfügung. Forschung am Fraunhofer IZM bedeutet auch, Elektronik zuverlässiger zu gestalten und seinen Kunden sichere Aussagen zur Haltbarkeit der Elektronik zur Verfügung zu stellen.

---

**Fachlicher Kontakt**

**Dr. Tanja Braun** | Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM | Telefon +49 30 46403-244 | Gustav-Meyer-Allee 25 | 13355 Berlin | [www.izm.fraunhofer.de](http://www.izm.fraunhofer.de) | [tanja.braun@izm.fraunhofer.de](mailto:tanja.braun@izm.fraunhofer.de) |